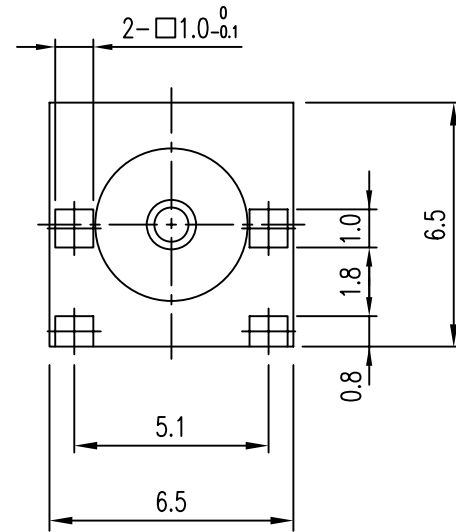
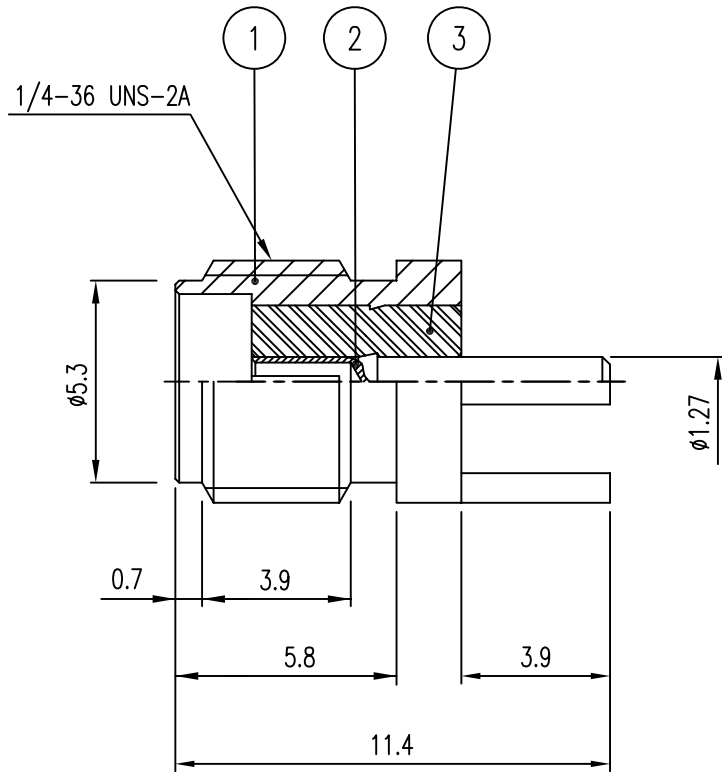


1										수 정 내 용				
ST	가	리								부	내	수	승	년
										호	용	정	인	월
ST(기초)										1	신뢰성 향상 (설번No.연 구2006-149) (PIN 밀립 방지 넘시베늘 삽입)	김인철	윤상진	2006. 7. 27.
ST(개선)										2	(설번No.201506-0010) BODY 넘시 베늘 추가 및 TEFLON 코트 변경	이현진	김인철	2015. 6. 8.



△2	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01973-N/1
△1	2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT01704-5/1
△2	1	BODY	1	MBSBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD02173-5/2

대체가능재질		품번		품 명		수량		재 질		표면처리		비 고	
공통공차		년월일 2015. 6. 8.						 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.					
소수 각도 분수		승인 I.C.KIM											
재질		검도 S.M.LEE						도명 SMA50 PCB JS-4R EDGE					
		제도 H.J.LEE											
열처리		작성부서 연 구 소						A4 도번 CN01439-7/1 K314-479-006					
보호파막처리		적도 5/1		단위 mm		중량							